

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006 年 1 月 26 日 (26.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/009147 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/24 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)

(KURODA, Hirofumi) [JP/JP]; 〒3213231 栃木県宇都宮市清原工業団地 20-7 住友ベークライト株式会社宇都宮工場内 Tochigi (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/013256
(22) 国際出願日: 2005 年 7 月 19 日 (19.07.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語

(74) 代理人: 岸本 達人, 外 (KISHIMOTO, Tatsuhito et al.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目 16 番 10 号 オークビル京橋 4 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).

(30) 優先権データ:
特願2004-214389 2004 年 7 月 22 日 (22.07.2004) JP
特願2004-245088 2004 年 8 月 25 日 (25.08.2004) JP
特願2004-245089 2004 年 8 月 25 日 (25.08.2004) JP
特願2005-003234 2005 年 1 月 7 日 (07.01.2005) JP
特願2005-096568 2005 年 3 月 29 日 (29.03.2005) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).

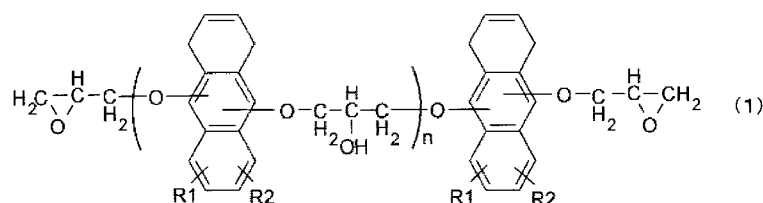
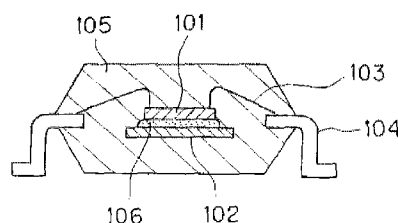
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, ...)

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 黒田 洋史

[続葉有]

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体封止用樹脂組成物および半導体装置



(57) Abstract: Disclosed is an epoxy resin composition for semiconductor sealing exhibiting excellent soldering resistance and flame resistance while having good fluidity and curability. Also disclosed is a semiconductor device. Specifically disclosed is a resin composition for semiconductor sealing which contains an epoxy resin (A) containing an epoxy resin (a) represented by the general formula (1) below, a compound (B) having two or more phenolic hydroxyl groups in a molecule, an inorganic filler (C) and a curing accelerator (D). (1) (In the general formula (1), R1 and R2 respectively represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 4 or less carbon atoms and may be the same as or different from each other, and n is a positive number having an average of not less than 0 and not more than 5.)

[続葉有]

WO 2006/009147 A1



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

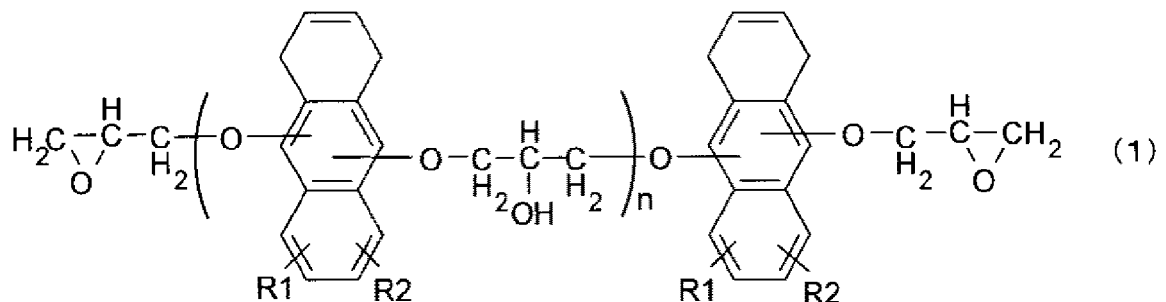
添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

本発明は、優れた耐半田性及び耐燃性を実現し、且つ良好な流動性及び硬化性を有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物及び半導体装置を提供することを目的とするものである。本発明は、下記一般式(1)で表されるエポキシ樹脂(a)を含むエポキシ樹脂(A)と、フェノール性水酸基を分子内に2つ以上有する化合物(B)と、無機充填剤(C)と、硬化促進剤(D)とを含む、半導体封止用樹脂組成物により、上記課題を解決した。

【化1】



(ただし、上記一般式(1)において、R1、R2は水素または炭素数4以下の炭化水素基でそれらは互いに同じでも異なっても良い。nは平均値で、0以上5以下の正数である。)